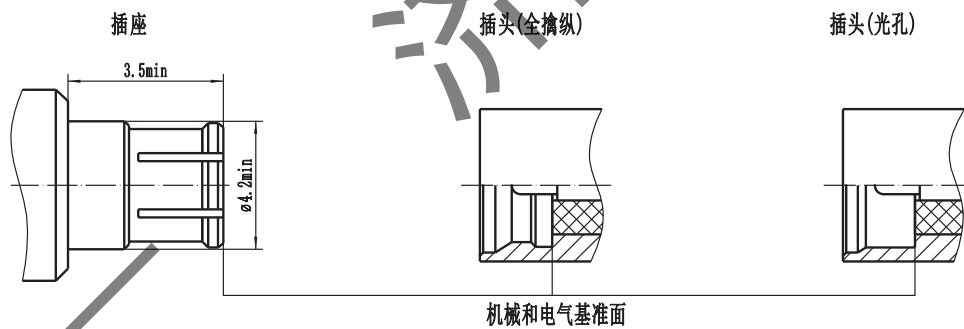


BSMP 系列产品整体介绍

BSMP是一种与SMP结构形式相同的新型盲插式射频连接器，使用方法与SMP相同，外形尺寸比SMP大22%左右，传输速率比SMP大30%~50%，适用于板间连接及模块化密集安装且功率要求较高的场合。由于BSMP尺寸较SMP产品大，所以其传输功率大。阳头产品有全擒纵结构及光孔两种界面，阴头产品只有一种界面形式，可与任何一种阳头界面插合使用。

界面尺寸



技术特性

特性阻抗	50 Ω		
频率范围	DC~26.5GHz DC~24GHz (气密封产品)		
额定电压	250VRMS*		
介质耐压	750VRMS*		
绝缘电阻	≥5000M Ω		
接触电阻	外导体	常规≤2.5m Ω, 气密封≤4m Ω	
	内导体	常规≤6m Ω, 气密封≤26m Ω	
电压驻波比	直式连接器	≤1.2	≤1.25
	转接器	≤1.15	≤1.2

*海平面最大值

传输功率介绍

由于ASMP尺寸较SMP产品大，所以其传输速率大，其中聚四氟乙烯介质产品功率比SMP的大30%。玻璃烧结类产品功率比SMP的大50%甚至更多。

材料及机械特性	内导体	阳头	锡磷青铜	镀金
		阴头	可伐合金	镀金
	弹性件	阳头	铍青铜	镀金
		阴头	铍青铜	镀金
	壳体及其他金属件	阳头	黄铜	镀金
		阴头	可伐合金	镀金
	绝缘介质	玻璃烧结/聚四氟乙烯/聚酰亚胺		
气密封产品漏率	1.01×10 ⁻³ Pa·cm ³ /s			

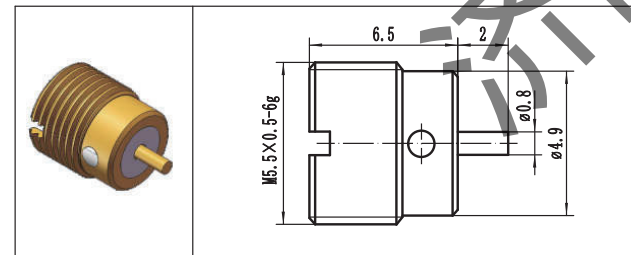
板间连接器类产品插针头部直径尺寸对照表

产品系列	SSMP	SMP	BSMP
插针头部直径	ø0.3	ø0.38	ø0.6

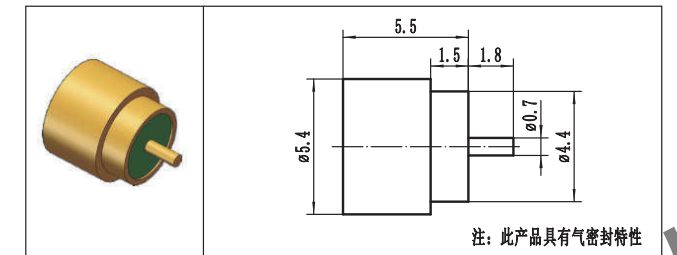
1. 可根据用户要求选择其它材质及镀层规格；
2. 未注公差等级IT13级。

微带系列

BSMP-JYD

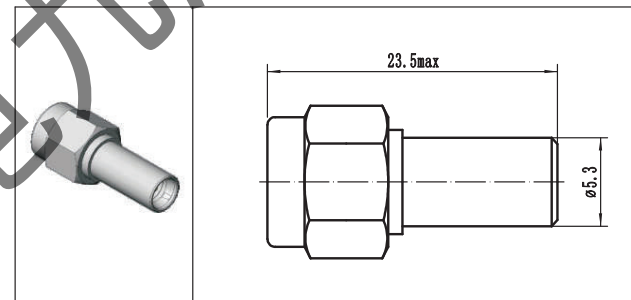


BSMP (M)-JYD2

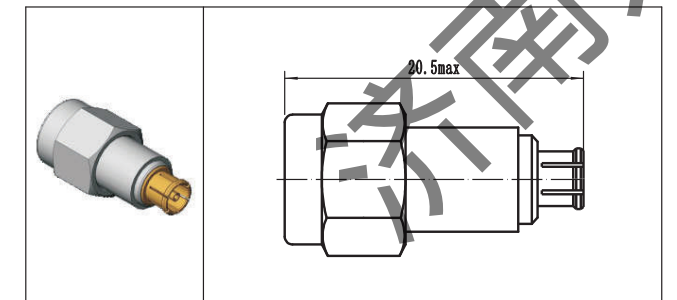


转接器系列 (系列间)

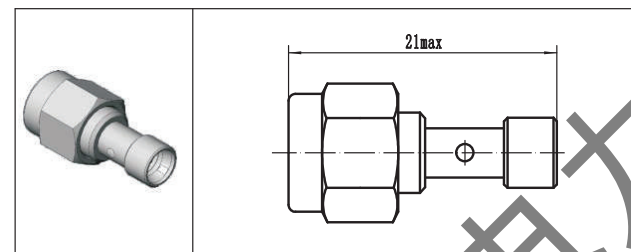
K/BSMP-JJG



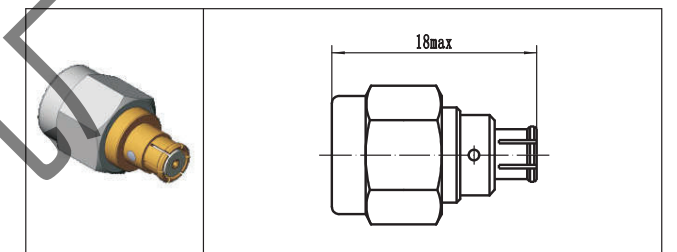
K/BSMP-JKG



SMA/BSMP-JJG

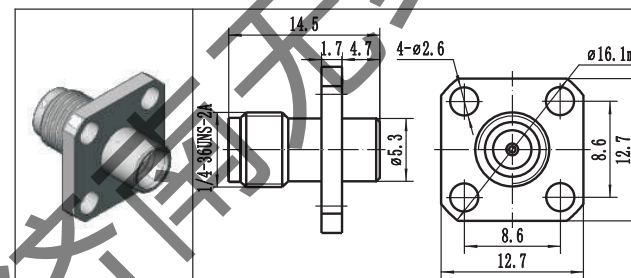


SMA/BSMP-JKG



转接器系列 (系列内)

K/BSMP-KFJG



BSMP-KK

